

Title (en)

Method for sealing a wooden building panel

Title (de)

Verfahren zum Versiegeln einer Bauplatte aus Holz oder einem Holzwerkstoff

Title (fr)

Procédé pour sceller un panneau de construction en bois

Publication

**EP 1512468 A2 20050309 (DE)**

Application

**EP 04020746 A 20040901**

Priority

DE 10341172 A 20030906

Abstract (en)

The method for sealing a building plate of wood or processed wood material consists of applying a liquid resin to the top surface, drying the resin, and compressing the plate. The last process takes place with addition of heat and at least partial melting of the resin.

Abstract (de)

Es wird ein Verfahren zum Versiegeln einer Bauplatte aus Holz oder einem Holzwerkstoff mit einer Oberseite und einer Unterseite mit folgenden Schritten vorgeschlagen: a) Auftragen von flüssigem Harz auf die Oberseite, b) Trocknen des Harzes, c) Verpressen der Bauplatte unter Temperatureinfluss, wobei das Harz zumindest teilweise schmilzt.

IPC 1-7

**B05D 7/06**; **B05D 3/12**; **E04F 13/10**; **E04F 15/04**; **E04G 9/04**

IPC 8 full level

**B05D 3/02** (2006.01); **B05D 3/12** (2006.01); **B05D 7/06** (2006.01); **B27M 3/04** (2006.01); **B27N 7/00** (2006.01); **E04F 13/10** (2006.01); **E04F 15/04** (2006.01); **E04G 9/04** (2006.01); **B05D 1/40** (2006.01)

CPC (source: EP US)

**B05D 3/0254** (2013.01 - EP US); **B05D 3/12** (2013.01 - EP US); **B05D 7/06** (2013.01 - EP US); **B27M 3/04** (2013.01 - EP US); **B05D 1/40** (2013.01 - EP US); **B05D 2252/10** (2013.01 - EP US); **B05D 2601/20** (2013.01 - EP US); **E04F 15/02** (2013.01 - EP US)

Cited by

DE102017119400A1; EP1918095A1; EP2098304A3; EP2402174A1; EP2589499A1; EP2546073A2; US11292291B2; EP2730430A1; WO2014072051A1; US9802222B2

Designated contracting state (EPC)

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LI LU MC NL PL PT RO SE SI SK TR

DOCDB simple family (publication)

**EP 1512468 A2 20050309**; **EP 1512468 A3 20060405**; **EP 1512468 B1 20091007**; AT E444815 T1 20091015; DE 10341172 A1 20050407; DE 10341172 B4 20090723; DE 10362218 B4 20100916; DE 502004010191 D1 20091119; EP 2098304 A2 20090909; EP 2098304 A3 20091209; EP 2098304 B1 20130227; ES 2331796 T3 20100115; PL 1512468 T3 20100331; PL 2098304 T3 20130830; US 2005089644 A1 20050428; US 8003168 B2 20110823

DOCDB simple family (application)

**EP 04020746 A 20040901**; AT 04020746 T 20040901; DE 10341172 A 20030906; DE 10362218 A 20030906; DE 502004010191 T 20040901; EP 09007035 A 20040901; ES 04020746 T 20040901; PL 04020746 T 20040901; PL 09007035 T 20040901; US 93233704 A 20040902